



半导体设备行业快评报告：美 日半导体设备出货额创新高 看好国内半导体设备成长性



事件：

1月26日，国际半导体产业协会（SEMI）和日本半导体制造装置协会（SEAJ）分别公布北美、日本半导体设备2021年出货金额，均创历史新高。根据SEMI数据，2021年12月北美半导体设备出货金额39.2亿美元，环比-0.5%，同比+46.1%；2021年出货总额达创纪录的429.9亿美元，同比+44.4%。根据SEAJ，2021年12月日本半导体设备制造出货额3033.7亿日元，环比+7.7%，同比+71.0%；2021年全年出货额达30767.6亿日元，同比+37.1%。

投资要点：

全球半导体设备市场景气度持续，预计今年全球晶圆厂设备支出继续增加。据SEMI和SEAJ数据，2021年北美、日本半导体设备出货额分别实现同比44.3%、37.1%的高增长，出货额创历史新高，设备市场维持高景气。根据SEMI《世界晶圆厂预测报告》（WorldFabforecast）数据，预计全球前端晶圆厂设备支出2022年将增长10%，超过980亿美元，创历史新高，实现继2020年增长17%及2021年增长39%后连续三年的正增长。

全球2022年新建10座晶圆厂，台积电上修今年资本开支至400亿美元以上。根据SEMI去年6月发布的《世界晶圆厂预测报告》，全球半导体制造商预计在2022年前开建29座高产能晶圆厂，资本支出超过1400亿美元。台积电2021Q4法说会上表示上修今年资本支出至400亿到440

亿美元 (2021 年资本开支 300 亿美元), 继续提振半导体设备行业市场信心。开支中 70%-80%用于先进制程, 10%用于先进封装, 10%-20%用于专业技术。

国内下游资本开支持续, 看好我国半导体设备国产替代。目前国内中芯国际、长江存储、华虹集团等进入扩产期, 为国产设备厂商带来订单机会。我国已成为全球最大半导体设备市场, 我国半导体设备已在多个细分领域实现关键技术突破: 去胶设备国产化率 90%+, 刻蚀、热处理、清洗设备国产化率 20%左右, PVD、CMP 设备国产化率 10%左右, 而离子注入、光刻机等国产化率较低。

去胶设备领域, 屹唐半导体 2020 年市场份额全球第一; 清洗设备领域, 盛美上海凭借兆声波清洗技术打入国内外客户生产线, 国内出货领先; 刻蚀设备领域, 中微公司、北方华创、屹唐半导体布局较多。目前半导体产业已上升到国家战略层面, 具有很强的国产化动力, 建议关注国产化率有望持续提升的半导体设备行业的投资机会。

风险因素: 宏观经济波动风险、下游资本开支不及预期风险

预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_36824

